

胜科纳米（苏州）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他 _____(请文字说明其他活动内容)
参与单位	线上参与公司 2025 年三季度业绩说明会的全体投资者
时间	2025 年 11 月 25 日
地点	价值在线 (https://www.ir-online.cn/) 网络互动
上市公司接待人员姓名	1. 董事长兼总经理：李晓旻 2. 董事会秘书：周秋月 3. 财务负责人：洪凯 4. 独立董事：陈海祥
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请问公司 2025 年三季度营收同比增长 31.22%，净利润增长 3.59%，公司业绩增长的主要原因是什么？增长是否具有可持续性？</p> <p>回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！2025 年前三季度公司营业收入 3.86 亿元，同比增长 31.22%；归母净利润 5,658.69 万元，同比增长 3.59%，主要是得益于下游半导体分析市场需求旺盛，公司积极拓展新客户资源且公司分析产能较上年同期进一步扩充，推动了业务及收入规模的增长。未来在人工智能、高性能计算及国产化趋势等的影响下，半导体检测分析需求有望进一步增长，公司作为半导体第三方检测分析实验室将迎来更多发展机遇。</p> <p>2. 公司目前主要盈利是哪个部门？能具体介绍一下运行情况吗？</p> <p>回答：公司是半导体第三方检测分析实验室，主营业务包括失效分析、材料分析和可靠性分析，公司业务以失效分析及材料</p>

分析为主，三类业务均具备较强的盈利能力。

3. 请问净利润增长，总利润为何下降 11%？

回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！2025 年前三季度公司利润总额同比有所下降，主要是由于苏州总部大楼投入使用、苏州总部及新建北京实验室新增设备，使得房屋建筑物及设备折旧增加；此外也受公司推进技术创新造成研发费用增加等的影响。未来随着苏州总部、北京等子公司实验室产能逐步释放，公司收入结构不断优化，利润有望得到提升。

4. 公司目前在可靠性分析领域进展如何？计划如何快速追赶上同业？这块业务毛利率较低未来随着此业务占比提升是否会拖累公司盈利能力？

回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司业务主要聚焦分析难度较高的失效分析与材料分析，可靠性分析的业务收入占比较低，2025 年上半年可靠性收入的营收占比约为 2.63%，后期公司会根据市场需求及战略规划进行业务布局。

5. 目前公司新建实验室进度如何？未来产能规划是怎样的？在伟测等其他第三方半导体测试厂商业绩回暖的情况下公司短期业绩增速放缓的原因是什么？公司业绩是否具有较大的周期性波动？

回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！2025 年公司新建苏州总部大楼及北京实验室，目前公司及子公司运营情况良好，为未来业绩增长提供充足产能，2025 年前三季度公司营收同比增长 31.22%。公司服务于半导体全产业链，下游终端应用产品每一轮需求的高增长，或先进制程等新工艺的量产，会促进半导体行业景气度提升，这将拉动半导体检测分析行业的发展。而在半导体行业增长放缓时，市场竞争加剧，半导体企业将缩减非核心的大额资本支出，选择更为经济的 Labless 模式，将检测分析需求委托至第三方实验室，公司作为半导体第三方检测分析实验室“辅助研发”的角色尤为重要。

6. 请问公司目前来自 GPU 公司的订单情况怎么样？对未来 GPU 的检测业务有没有一些预测？

回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司紧跟半导体产业下游技术发展，持续进行前沿分析技术研发，已形成电性测试及光热点探测失效定位技术、高分辨率透射电镜成像结构检测分析技术等核心技术，可以为 GPU 芯片公司在内的芯片设计、晶圆代工、封测、IDM 等半导体客户提供检测分析

服务，并满足其先进制程、先进封装等不同工艺分析要求。目前公司来自 GPU 芯片公司的订单有所增长，未来随着先进制程的不断演进，国内晶圆代工企业良率的提升，GPU 芯片设计公司检测分析需求将进一步增长。

7. 公司提出了五代产线概念，请问其中的第四代产线目前最新进展及获取的客户订单情况？

回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！先进制程芯片的复杂电路设计及高集成度对失效分析的电性测试提出更高要求，公司第四代产线运用晶体管级纳米探针分析技术有效解决了先进制程 SRAM（逻辑电路中密度最高、工艺最复杂的模块）的失效分析场景。目前第四代产线客户数量及订单需求持续增加，并为公司实现了较高的毛利率，公司将根据市场需求及整体发展规划，有序增设第四代产线的建设布局。

8. 公司为何主攻失效分析与材料分析领域？目前该领域市场集中度低且市场规模较小，公司计划如何应对？

回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！从分析实验过程来看，失效分析及材料分析的流程环节更加复杂，失效分析及材料分析通常需要对客户提供的样品进行制备，材料分析还对数据解读提出较高要求；除此以外，相较于可靠性分析，失效分析及材料分析所需仪器更加精密，操作难度更高，且失效分析及材料分析的单位案件单价通常更高。因此，失效分析及材料分析相较于可靠性分析具备更高的技术难度及更高的附加值。与主要竞争对手相比，在公司主要聚焦的失效分析以及材料分析领域，公司业务份额相对较高。未来在半导体产业整体快速发展的情况下，公司市场占有率有望进一步提升。

9. 请问：公司目前在全国建立的分公司，是否满足现在全国各区域业务覆盖需求？未来是否还有必要再成立新的分公司？

回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司主要根据各区域半导体产业聚集情况和发展规划，重点选择在半导体产业集群区域进行布点，未来将根据客户需求及市场发展情况进行实验室规划布局。

10. 随着公司市场规模的不断扩大，公司在收购兼并与对外扩张方面，是如何规划的？

回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司未来将根据下游客户需求、现有产能利用水平、市场发展趋势以及公

司战略规划进行综合考虑，深耕半导体分析测试领域，巩固当前在失效分析、材料分析领域的优势，积极探索在科技创新领域的应用，打造一站式检测分析及辅助研发平台。公司后续业务规划请关注公司披露公告。

11. 截止上半年，公司还有哪个分公司处于非盈利状态？

回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司及子公司盈利情况请关注公司后续定期报告。

12. 今年来有看到半导体产业链多环节的先进工艺参与者都在增多，公司看到的这些新进入者的订单情况怎么样？

回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！目前公司提供的分析实验更多地聚焦先进工艺，今年以来，公司来自于先进制程（28nm 及以下制程）、高端特色工艺（高性能模拟芯片、高集成度射频芯片、高容量内存芯片、高密度光电器件、功率半导体器件等）、先进封装（混合键合、晶圆级封装、2.5D 封装、3D 封装、系统级封装等）、先进材料（第三代半导体材料、大硅片、光刻胶）等先进工艺领域订单和收入同比增长。从客户所处的产业链环节来看，来自晶圆代工企业和设备厂商的订单和收入同比均保持增长态势。

13. 公司登录资本市场后，迎来巨大的发展机会，希望公司聚焦主业，吸纳招募到更多优秀的人才，可以考虑合适的时候尽快推出合理的股权激励计划。

回答：尊敬的投资者，感谢您的建议！公司高度重视人才培养，自成立以来已实施一系列激励计划激励核心员工。后续公司将依托资本市场平台，采取一系列激励计划激励核心员工，进一步增强公司的竞争力。

14. 随着 AI 芯片发展，存储需求越来越大，HBM 高带宽存储芯片已经成为决定 AI 发展的重要部分，请问公司有 HBM 相关的检测分析技术吗？对后期市场是怎么看的？

回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司已针对存储芯片高深宽比刻蚀工艺、高密度复杂电路特点等进行技术创新，目前掌握 HBM 高带宽存储芯片等分析解决方案。随着 AI 产业热潮的推动、半导体国产化进程的深化，HBM 高带宽存储芯片等迎来快速发展，将进一步推动公司相关芯片检测分析需求的增长。

	<p>15. 公司近期新闻公布与浙江大学开展在 AI 领域的科研合作，能具体介绍一下相关内容？</p> <p>回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！11月18日，公司与浙江大学成功签署科研合作协议，共同启动“多维度理论计算赋能半导体产业新发展”项目，双方将围绕“基于AI技术构建面向新型半导体材料工艺研发的智算设计系统”展开深度合作。胜科纳米深耕半导体失效分析、材料表征等第三方检测服务多年，拥有丰富的产业数据和技术场景，该合作项目是公司在AI技术应用上的前瞻性布局，包括将AI技术融入分析测试和辅助半导体行业器件、工艺、材料开发，以应对前沿科技需求。</p>
风险提示及说明	<p>以上如涉及对行业的预测、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的盈利预测和承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>投资者接待活动过程中，公司接待人员积极回复投资者提出的问题，回复的内容符合公司《信息披露管理制度》等制度的规定，回复的信息真实、准确，本次活动不存在应当披露的重大信息。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025年11月25日